

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Bescheinigung

1525 U.S. PTO  
09/483923  
01/18/00

#1 Priority Paper  
DETAILED  
8.11.00

Die PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH in Hamburg/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Spannungsfester Dünnschichtkondensator mit Interdigitalstruktur"

am 20. Januar 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig das Symbol H 01 G 4/30 der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**

München, den 27. Mai 1999

**Deutsches Patent- und Markenamt**

**Der Präsident**

Im Auftrag

Aktenzeichen: 199 02 029.9

Sieck

ZUSAMMENFASSUNG

## Spannungsfester Dünnschichtkondensator mit Interdigitalstruktur

Die Erfindung betrifft einen Dünnschichtkondensator mit einem Trägersubstrat (1), wenigstens zwei interdigitalen Elektroden (4, 5) und einem Dielektrikum (3). Durch eine  
5 versetzte Anordnung wenigstens einer interdigitalen Elektrode (4) unterhalb des Dielektrikums (3) zu einer interdigitalen Elektrode (5) oberhalb des Dielektrikums (3) wird ein spannungsfester Dünnschichtkondensator erhalten, der mit dem gleichen Produktionsprozeß hergestellt werden kann, wie ein Standard-Monolagenkondensator.

10 Fig. 1

BESCHREIBUNG

## Spannungsfester Dünnschichtkondensator mit Interdigitalstruktur

Die Erfindung betrifft einen Dünnschichtkondensator, welcher ein Trägersubstrat, wenigstens zwei interdigitale Elektroden und wenigstens ein Dielektrikum aufweist.

5

- Dielektrische Materialien mit hohen Dielektrizitätskonstanten ( $\epsilon_r > 50$ ) werden eingesetzt, um in Kondensatoren hohe Kapazitäten auf kleinen Abmessungen zu erreichen. Bei der Herstellung von Dünnschichtkondensatoren werden mittels Dünnschichtprozessen Dielektrika mit  $\epsilon_r > 50$  in dielektrischen Dicken von 50 nm bis 2  $\mu$ m hergestellt. Als kostengünstiges Verfahren zur Abscheidung dünner Schichten mit  $\epsilon_r > 50$  wird ein naßchemisches Dünnschichtverfahren wie beispielsweise das Sol-Gel-Verfahren eingesetzt. Als Grundlektrode dient in den Dünnschichtkondensatoren eine Nichtedelmetallelektrode wie zum Beispiel eine Aluminium- oder Kupferelektrode oder auch eine Edelmetallelektrode beispielsweise aus Silber, Silberlegierungen oder Platin. Für die Oberelektrode werden wie bei der Grundlektrode Edelmetalle wie zum Beispiel Platin, Silber, Silberlegierungen oder NiCr/Gold oder auch Nichtedelmetalle wie zum Beispiel Aluminium, Nickel oder Kupfer eingesetzt. Diese werden mit Dünnschichtverfahren wie zum Beispiel Sputtern oder chemische Abscheidung aus der Gasphase aufgebracht. Zur Strukturierung der Elektroden werden lithographische Prozesse verbunden mit Naß- oder Trockenätzschritten verwendet.
- 20 Als Trägersubstratmaterialien kommen Si-Wafer, Glas- oder Keramikmaterialien zur Anwendung. Zum Schutz des Kondensatoraufbaus wird eine Schutzschicht beispielsweise eine organische Schicht und/oder eine anorganische Schicht durch ein Druckverfahren oder ein Dünnschichtverfahren aufgebracht. Außerdem werden die Kondensatoren entweder einzeln oder in Streifen mit Stromzuführungen versehen.

25

- Dieser Stand der Technik reicht aus, um kostengünstige, den Standardspezifikationen entsprechende, Dünnschichtkondensatoren herzustellen. Die Schichtdicken von etwa einem Mikrometer reichen aber nicht aus, um für Hochfrequenzanwendungen bei kleinen Kapazitätswerten von einigen Picofarad höhere Betriebsspannungen  $U_{\text{rated}}$  (50 V, 100 V und höher) mit den zusätzlich geforderten Lebensdauern zu erreichen.
- 30

Eine höhere Spannungsfestigkeit zeigen sogenannte Interdigitalkondensatoren, deren Elektroden eine Fingerstruktur aufweisen. Die fingerartigen Ausbildungen dieser interdigitalen Elektroden und deren Verzahnung bilden mit dem darüberliegenden Dielektrikum den eigentlichen Kondensator. Die Kapazität einer solchen Anordnung ist eine Funktion des Fingerabstandes, der Länge der Verzahnung, der Dicke des Dielektrikums, der Dielektrizitätskonstanten von Substrat und Dielektrikum und der Dicke der Elektroden. Der Fingerabstand bestimmt im wesentlichen die Durchschlagfestigkeit und damit die zulässige Betriebsspannung des Kondensatortyps.

10

Aus Publikationsnummer 07283076 A der "Patent Abstracts of Japan" ist eine Kondensatoranordnung mit interdigitalen Elektroden bekannt, bei der zusätzlich zur Erhöhung der Kapazität mehrere interdigitale Elektrodenschichten übereinander angeordnet sind. Die interdigitalen Elektroden einer Kondensatoreinheit liegen jeweils in einer Ebene und zwischen den einzelnen Elektrodenebenen befindet sich ein Dielektrikum. Ein Nachteil der Anordnung der Elektroden in einer Ebene besteht darin, daß nicht die volle Dicke des Dielektrikums zur Kapazität des Kondensators beiträgt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Dünnschichtkondensator mit interdigitalen Elektroden und hoher Spannungsfestigkeit zu entwickeln.

Die Aufgabe wird gelöst durch einen Dünnschichtkondensator, welcher ein Trägersubstrat, wenigstens zwei interdigitale Elektroden und wenigstens ein Dielektrikum aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine interdigitale Elektrode unterhalb und wenigstens eine interdigitale Elektrode oberhalb des Dielektrikums angeordnet ist.

Bei der Anordnung der interdigitalen Elektroden unter- und oberhalb des Dielektrikums tragen die Schichten des Dielektrikums zum Kapazitätsverhalten des Kondensators bei.

Eine bevorzugte Ausführung sieht vor, daß die interdigitale Elektrode oberhalb des Dielektrikums versetzt zu der interdigitale Elektrode unterhalb des Dielektrikums angeordnet ist.

Diese versetzte Anordnung bewirkt, daß das Dielektrikum gleichmäßiger vom elektrischen Feld durchdrungen wird und somit höhere Kapazitäten erzielt werden können, bei sonst identischen Parametern.

5

Eine weitere bevorzugte Ausführung sieht vor, daß das Dielektrikum multiple Schichten aufweist.

10 Durch Verwendung von multiplen Schichten, beispielsweise Doppel-, Dreifach- oder Vierfachsichten, kann das ungünstige Temperaturverhalten einiger dielektrischer Materialien ausgeglichen und die Temperaturabhängigkeit des Kapazitätswertes des Dünnschichtkondensators verbessert werden.

15 In einer bevorzugten Ausführung enthält das Dielektrikum ein ferroelektrisches Keramikmaterial.

Ferroelektrische Keramikmaterialien besitzen eine große relative Dielektrizitätskonstante  $\epsilon_r$  und ermöglichen hohe Kapazitäten auf kleinen Abmessungen.

20 Es ist außerdem bevorzugt, daß auf dem Trägersubstrat eine Barrierschicht aufgebracht ist.

Durch eine Barrierschicht können bei oberflächenrauen Trägersubstraten, beispielsweise  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , Reaktionen mit dem Dielektrikum oder Kurzschlüsse vermieden werden.

25

Im folgenden soll die Erfindung anhand einer Figur und zweier Ausführungsbeispiele erläutert werden. Dabei zeigt

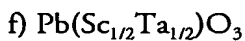
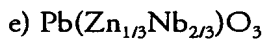
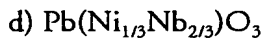
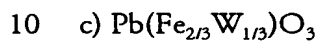
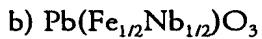
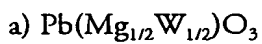
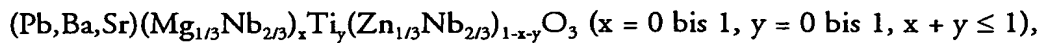
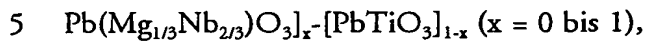
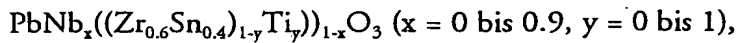
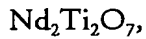
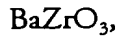
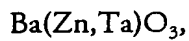
Fig. 1: den schematischen Aufbau eines Dünnschichtkondensators mit zwei  
30 interdigitalen Elektroden  
und

Fig. 2: den schematischen Aufbau eines Dünnschichtkondensators mit drei interdigitalen Elektroden.

- Gemäß Fig. 1 weist ein Dünnschichtkondensator ein Trägersubstrat 1 auf, welches zum
- 5 Beispiel aus einem keramischen Material, einem glaskeramischen Material, einem Glasmaterial oder Silicium ist. Auf dem Trägersubstrat 1 ist eine Barrierschicht 2 beispielsweise aus  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  oder  $\text{ZrO}_2$  aufgebracht. Auf dieser Barrierschicht 2 befindet sich eine erste interdigitale Elektrode 4, welche beispielsweise Al,
- Al dotiert mit Cu,
- 10 Cu,  
W,  
Pt,  
Ni,  
Pd,
- 15 Pd/Ag,  
TiW/Al,  
Ti/Pt,  
Ti/Ag,  
Ti/Ag/TiIr,
- 20  $\text{Ti/Ag}_x\text{Pt}_{1-x}$  ( $x = 0$  bis 1),  
 $\text{Ti/Ag/Pt}_x\text{Al}_{1-x}$  ( $x = 0$  bis 1),  
 $\text{Ti/Ag}_x\text{Pt}_{1-x}/\text{Ir}$  ( $x = 0$  bis 1),  
 $\text{Ti/Ag}/(\text{Ir}/\text{IrO}_x)$  ( $x = 0$  bis 2),  
 $\text{Ti/Ag/Ru}_x\text{Pt}_{1-x}$  ( $x = 0$  bis 1),
- 25  $\text{Ti/Pt}_x\text{Al}_{1-x}/\text{Ag/Pt}_y\text{Al}_{1-y}$  ( $x = 0$  bis 1,  $y = 0$  bis 1),  
 $\text{Ti/Ag/Pt}_y(\text{RhO}_x)_{1-y}$  ( $x = 0$  bis 2,  $y = 0$  bis 1),  
 $\text{Ti/Ag/Pt}_x\text{Rh}_{1-x}$  ( $x = 0$  bis 1),  
 $\text{Ti/Ag}_x\text{Pt}_{1-x}/(\text{Ir}/\text{IrO}_y)$  ( $x = 0$  bis 1,  $y = 0$  bis 2),  
 $\text{Ti/Ag}_x\text{Pt}_{1-x}/\text{Pt}_y\text{Al}_{1-y}$  ( $x = 0$  bis 1,  $y = 1$ ),
- 30 Ti/Ag/Ti,  
Ti/Ni/ITO oder

NiCrAl/Ni enthält. Auf der unteren interdigitalen Elektrode 4 wird ein Dielektrikum 3 aufgebracht, welches eine hohe relative Dielektrizitätskonstante von  $\epsilon_r > 20$  aufweist. Das Dielektrikum 3 kann zum Beispiel  $\text{Pb}(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$  ( $x = 0$  bis 1) mit und ohne Bleiüberschuß,

- 5  $(\text{Pb},\text{Ba})(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_x(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_y\text{Ti}_2\text{O}_3$  ( $x = 0$  bis 1,  $y = 0$  bis 1,  $z = 0$  bis 1),  
 $\text{Ba}_{1-x}\text{Sr}_x\text{TiO}_3$  ( $x = 0$  bis 1),  
 $\text{Pb}_{1-1.5y}\text{La}_y(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$  ( $x = 0$  bis 1,  $y = 0$  bis 0.2),  
 $\text{SrTi}_{1-x}\text{Zr}_x\text{O}_3$  ( $x = 0$  bis 1),  
 $(\text{Zr},\text{Sn})\text{TiO}_4$ ,
- 10  $\text{Ta}_2\text{O}_5$  mit  $\text{Al}_2\text{O}_3$  Dotierungen,  
 $\text{Pb}_{1-\alpha y}\text{La}_y\text{TiO}_3$  ( $y = 0$  bis 0.3,  $\alpha = 1.3$  bis 1.5),  
 $(\text{Pb},\text{Ca})\text{TiO}_3$ ,  
 $\text{BaTiO}_3$  mit und ohne Dotierungen,  
 $\text{Ba}_2\text{Ti}_9\text{O}_{20}$ ,
- 15  $\text{CaSm}_2\text{Ti}_5\text{O}_{14}$ ,  
 $\text{TiZr}_{0.8}\text{Sn}_{0.2}\text{O}_4$ ,  
 $\text{Ba}_2\text{Ti}_{8.53}\text{Zr}_{0.50}\text{Mn}_{0.01}\text{O}_{20}$ ,  
 $\text{SrZr}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_3$  ( $x = 0$  bis 1) mit und ohne Mn Dotierungen,  
 $\text{BaZr}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_3$  ( $x = 0$  bis 1),
- 20  $\text{Ba}_{1-y}\text{Sr}_y\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_3$  ( $x = 0$  bis 1,  $y = 0$  bis 1),  
 $\text{Ba}_{1-x}\text{Sr}_x\text{TiO}_3$  ( $x = 0$  bis 1),  
 $\text{SrTiO}_3$  mit Dotierungen von z.B. La, Nb, Fe oder Mn,  
 $(\text{BaTiO}_3)_{0.18-0.27} + (\text{Nd}_2\text{O}_3)_{0.316-0.355} + (\text{TiO}_2)_{0.276-0.355} + (\text{Bi}_2\text{O}_3)_{0.025-0.081} + x \text{ZnO}$ ,  
 $\text{CaZrO}_3$ ,
- 25  $\text{CaTiO}_3 + \text{CaTiSiO}_5$ ,  
 $(\text{Sr},\text{Ca})(\text{Ti},\text{Zr})\text{O}_3$ ,  
 $(\text{Sr},\text{Ca},\text{M})(\text{Ti},\text{Zr})\text{O}_3$  (M= Mg oder Zn),  
 $(\text{Sr},\text{Ca},\text{Cu},\text{Mn},\text{Pb})\text{TiO}_3 + \text{Bi}_2\text{O}_3$ ,  
 $\text{BaO-TiO}_2\text{-Nd}_2\text{O}_3\text{-Nb}_2\text{O}_5$ ,
- 30  $(\text{Ba},\text{Ca})\text{TiO}_3 + \text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Co}_2\text{O}_3$ ,  $\text{MnO}_2$ ,  
 $\text{TiO}_2$ ,  
 $\text{BaO-PbO-Nd}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ ,



sowie Kombinationen der Verbindungen a)- f) mit  $\text{PbTiO}_3$  und  $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$  mit

15 und ohne Bleiüberschuß enthalten. Auf dem Dielektrikum 3 ist eine obere interdigitale Elektrode 5 aufgebracht, die zum Beispiel Al,

Al dotiert mit Cu,

Cu,

W,

20 Pt,

Ni,

Pd,

Pd/Ag,

TiW/Al,

25 Ti/Pt,

Ti/Ag,

Ti/Ag/TiIr,

Ti/Ag<sub>x</sub>Pt<sub>1-x</sub> (x = 0 bis 1),

Ti/Ag/Pt<sub>x</sub>Al<sub>1-x</sub> (x = 0 bis 1),

30 Ti/Ag<sub>x</sub>Pt<sub>1-x</sub>/Ir (x = 0 bis 1),

Ti/Ag/(Ir/IrO<sub>x</sub>) (x = 0 bis 2),

Ti/Ag/Ru<sub>x</sub>Pt<sub>1-x</sub> (x = 0 bis 1),



- $\text{Ti/Pt}_x\text{Al}_{1-x}/\text{Ag/Pt}_y\text{Al}_{1-y}$  ( $x = 0$  bis  $1$ ,  $y = 0$  bis  $1$ ),  
 $\text{Ti/Ag/Pt}_y(\text{RhO}_x)_{1-y}$  ( $x = 0$  bis  $2$ ,  $y = 0$  bis  $1$ ),  
 $\text{Ti/Ag/Pt}_x\text{Rh}_{1-x}$  ( $x = 0$  bis  $1$ ),  
 $\text{Ti/Ag}_x\text{Pt}_{1-x}/(\text{Ir/IrO}_y)$  ( $x = 0$  bis  $1$ ,  $y = 0$  bis  $2$ ),  
 5  $\text{Ti/Ag}_x\text{Pt}_{1-x}/\text{Pt}_y\text{Al}_{1-y}$  ( $x = 0$  bis  $1$ ,  $y = 1$ ),  
 $\text{Ti/Ag/Ti}$ ,  
 $\text{Ti/Ni/ITO}$  oder  
 $\text{NiCrAl/Ni}$  enthält.

- 10 Alternativ kann das Dielektrikum 3 multiple Schichten, beispielsweise Doppel-, Dreifach- oder Vierfachschichten, aufweisen.

Außerdem kann ein Mehrschichtaufbau mit drei oder mehr versetzten interdigitalen Elektroden eingesetzt werden.

15

In Fig. 2 ist ein solcher Mehrschichtaufbau mit drei versetzten interdigitalen Elektroden 41, 42 und 51 und zwei Dielektrika 31 und 32 gezeigt. In dieser Ausführung des erfindungsgemäßen Dünnschichtkondensators befinden sich über einer ersten interdigitalen Elektrode 41 zunächst ein erstes Dielektrikum 31, darüberliegend eine zweite interdigitale Elektrode 51, darüberliegend ein zweites Dielektrikum 32 und eine dritte interdigitale Elektrode 42. Die erste interdigitale Elektrode 41 und die dritte interdigitale Elektrode 42 sind parallel geschaltet.

20

- Im folgenden werden Ausführungsformen der Erfindung erläutert, die beispielhafte Realisierungsmöglichkeiten darstellen.

25

Ausführungsbeispiel 1:

- Ein Trägersubstrat 1 aus Glas wird mit einer Barrierschicht 2 aus  $\text{TiO}_2$  versehen. Auf diese Barrierschicht 2 wird eine untere interdigitale Elektrode 4 aus  $\text{Ti/Pt}$  aufgebracht. Über der unteren interdigitalen Elektrode 4 befindet sich ein Dielektrikum 3 aus  $\text{BaTiO}_3$ . Auf dieses Dielektrikum 3 wird eine obere interdigitale Elektrode 5 aus  $\text{Pt}$  aufgebracht.

30

### Ausführungsbeispiel 2:

- Ein Trägersubstrat 1 aus Glas wird mit einer Barrierschicht 2 aus  $\text{TiO}_2$  versehen. Auf diese Barrierschicht 2 wird eine untere interdigitale Elektrode 4 aus Ti/Pt aufgebracht. Über der unteren interdigitalen Elektrode 4 befindet sich ein Dielektrikum 3 aus Lanthan-dotiertem  $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.53}\text{Ti}_{0.47})\text{O}_3$ . Auf dieses Dielektrikum 3 wird eine obere interdigitale Elektrode 5 aus Pt aufgebracht.
- 10 Im gleichen Herstellungsprozeß werden auch Standard-Monolagenkondensatoren hergestellt. Die Ergebnisse aus drei Versuchen sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

**Tabelle 1:** Standard-Monolagenkondensator mit  $20 \text{ V}/\mu\text{m}$  und  $13 \text{ nF}/\text{mm}^2$

	Versuch 1	Versuch 2	Versuch 3	Mittelwert
rel. Dielektrizitätskonstante $\epsilon_r$	1120	1060	1070	1083
Dielektrikum $[\mu\text{m}]$	0.754	0.784	0.702	0.747
Betriebsspannung $U_{\text{rated}}$ [V]				15

15

**Tabelle 2:** Parameter für die interdigitalen Elektroden

Anzahl der Finger:	12
Anzahl der Lücken:	11
Länge der Verzahnung $[\mu\text{m}]$ :	850
Gesamtlänge der Verzahnung $[\mu\text{m}]$ :	9350

- In Tabelle 3 sind die gemittelten Kapazitätswerte  $C$  und die Betriebsspannungen  $U_{\text{rated}}$  für Dünnschichtkondensatoren mit interdigitalen Elektroden (Parameter entsprechend Tabelle 2) und Lanthan-dotiertem PZT-Dielektrikum (Schichtdicken entsprechend Tabelle 1) angegeben.
- 20

**Tabelle 3:** Gemittelte Kapazitätswerte  $C$  für Dünnschichtkondensatoren mit interdigitalen Elektroden und Lanthan dotierten PZT-Dielektrikum.

Fingerabstand [ $\mu\text{m}$ ]	Kapazität $C$ [pF]	Betriebsspannung $U_{\text{rated}}$ [V]
10	6.3	200
5	10.8	100
3	17.5	60

PATENTANSPRÜCHE

1. Dünnschichtkondensator, welcher ein Trägersubstrat (1), wenigstens zwei interdigitale Elektroden (4, 5) und wenigstens ein Dielektrikum (3) aufweist,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß wenigstens eine interdigitale Elektrode (4) unterhalb und wenigstens eine interdigitale  
5 Elektrode (5) oberhalb des Dielektrikums (3) angeordnet ist.
2. Dünnschichtkondensator nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die interdigitale Elektrode (5) oberhalb des Dielektrikums (3) versetzt zu der  
10 interdigitalen Elektrode (4) unterhalb des Dielektrikums (3) angeordnet ist.
3. Dünnschichtkondensator nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß das Dielektrikum (3) multiple Schichten aufweist.  
15
4. Dünnschichtkondensator nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß das Dielektrikum (3) ein ferroelektrisches Keramikmaterial enthält.
- 20 5. Dünnschichtkondensator nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß auf dem Trägersubstrat (1) eine Barrierschicht (2) aufgebracht ist.

1/2

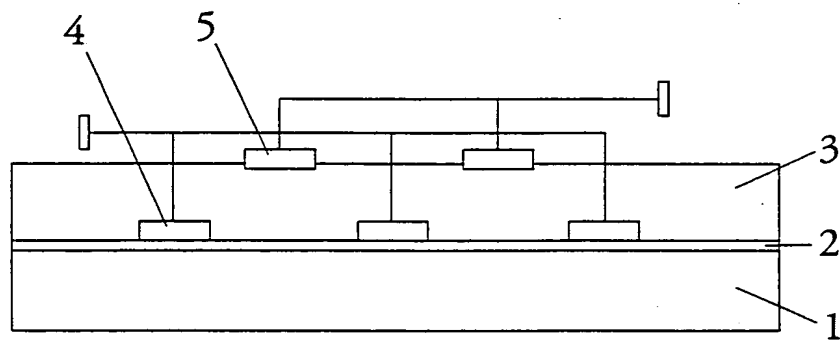


FIG. 1

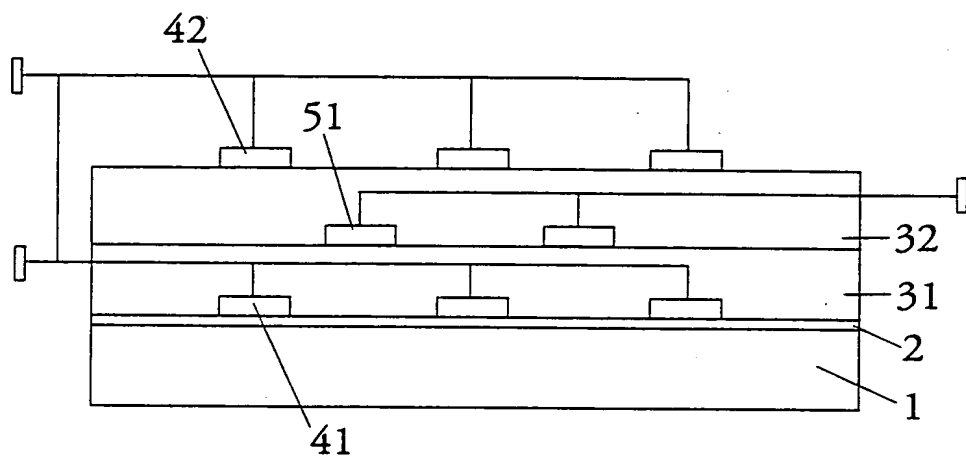


FIG. 2